

	<p>投、矽昌微电子、峰林资本、瑞泰人寿、中邮人寿、博裕资本、中银三星人寿、台湾施罗德、申银万国、中船财务、鸿商集团、苏银理财、华能贵诚信托、亚洲霸菱资管、上海贺腾资管、上海南土资管、大家资管、中再资管、广发证券资管、浙商资管、上海石锋资管、上海湘楚资管、长江资管、上海涌贝资管、华夏久盈资管、国泰君安资管、财通证券资管、华安财保资管、上汽顾臻资管、东方证券资管、上海见龙资管、上海睿郡资管、上海尘星资管、浙江米仓资管、北京清和泉资管、青岛朋元资管、众志汇通资管、中国人寿资管、深圳领骥资管、浙江四叶草资管、上海常春藤资管、招商信诺资管、敦和资管、东证融汇证券资管、复星集团、金股证券投资、西部证券、中金公司、华泰证券、东北证券、广发证券、长江证券、民生证券、西南证券、上海证券、申银万国证券、银河证券、中信建投、浙商证券、中信证券、华鑫证券、开源证券、东吴证券、信达证券、中泰证券、南京证券、天风证券、兴业证券、安信证券、中航证券、财通证券、汇丰前海证券、光大证券、德邦证券、国泰君安、国信证券、海通证券、招商证券、山西证券、国海证券、国金证券、万联证券、东方财富证券、野村东方国际证券、平安证券、国联证券、首创证券、东方证券、瑞信证券、万和证券、个人投资者（排名不分先后）</p>
<p>时间</p>	<p>2023年3月31日 10:00</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>副总经理、董事会秘书：蒋威 证券投资部：王渝、陈小曼、陈卓璜、肖晓月</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、公司 2022 年度经营情况介绍</p> <p>受限于行业层面需求不振、竞争加剧的压力，公司并未实现年初预定的经营目标，整体营收仅实现个位数增长，且净利润受费用拖累有所下滑。报告期内，公司实现营业收入 535,385.50 万元、同比增长 6.23%；归属于上市公司股东的净利润 52,563.31 万元、同比下降 15.42%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39,549.98 万元、同比下降 33.08%；总资产 1,188,829.53 万元、较上年末增长 43.19%；归属于上市公司股东的净资产 653,855.76 万元、较上年末增长 73.79%。2022 年，公司整体毛利率下降 3.51 个百分点；期间费用率增加 2.95 个百分点，其中，销售费用率下降 0.02 个百分点，管理费用率增加 1.18 个百</p>

分点，研发费用率增加 1.41 个百分点，财务费用率增加 0.38 个百分点。

报告期内，公司各业务板块经营情况如下：

（一）PCB 业务平稳增长，盈利能力有所下滑

报告期内，PCB 行业面临需求不振和竞争加剧的双重压力，增长不达预期。公司 PCB 业务实现收入 403,017.45 万元、同比增长 6.22%，毛利率 30.29%、同比下降 2.84 个百分点。子公司宜兴硅谷在通信和服务器领域的大客户端实现量产突破，全年实现收入 82,403.29 万元、同比增长 22.28%，净利润 2,555.69 万元、同比下降 59.58%，主要系批量板毛利率较低叠加产能利用率不足。Fineline 维持平稳增长，实现收入 151,115.93 万元、同比增长 17.21%，净利润 13,834.50 万元、同比增长 21.72%。英国 Exception 实现收入 6,191.83 万元、同比下降 8.22%，净利润 102.06 万元，同比下降 82.86%，主要系产线升级更新叠加成本上升。

（二）半导体业务持续聚焦 IC 封装基板业务的投资扩产

报告期内，公司半导体业务实现收入 114,897.08 万元、同比增长 6.05%，毛利率 17.25%、同比下降 6.79 个百分点。其中，IC 封装基板业务实现收入 68,954.21 万元、同比增长 3.45%；毛利率 14.75%、同比下降 11.60 个百分点。毛利率下降主要受新增产能拖累以及行业需求大幅下滑导致整体产能利用率下降影响，其中，广州兴科全年亏损 8,292.62 万元。FCBGA 封装基板项目仍处于建设阶段，未产生收入贡献，但整体人工成本、研发投入、试生产损耗等对公司利润形成较大拖累，FCBGA 封装基板项目全年费用投入约 10,200 万元。

半导体测试板业务实现营收 45,942.87 万元、同比增长 10.21%，毛利率 21.00%、同比提升 0.66 个百分点，主要受益于广州基地半导体测试板工厂新产能贡献，交期和良率指标持续改善。其中，Harbor 实现营收 34,940.93 万元、同比下降 2.94%，净利润 1,328.75 万元、同比下降 65.28%，主要系新产品、新技术研发支出增多叠加成本上升影响。

二、FCBGA 封装基板项目建设进展介绍

珠海 FCBGA 封装基板项目已于 2022 年 12 月底建成并成功试产，预计于 2023 年第二季度开始启动客户认证、第三季度进入小批量试生产阶段。

广州 FCBGA 封装基板项目于 2022 年 9 月实现厂房封顶，目前正在进

行厂房装修，预计 2023 年第四季度完成产线建设，开始试产。

现阶段，公司一方面强化工厂能力提升和数字化建设，努力提升产品良率；另一方面全力开拓下游客户，与国内外部分主流的芯片设计公司、封装企业均已建立起联系，为下一阶段的批量生产储备客户资源。

三、CSP 封装基板发展预期介绍

存储芯片行业是公司 CSP 封装基板领域最大的下游市场，收入占比约 2/3。受行业景气度低迷及消费电子去库存影响，CSP 封装基板需求不振，公司 CSP 封装基板产能利用率不高，但预计 Q3 需求会逐步回暖，叠加大客户订单逐渐提升，产能利用率有望逐步提升。

从行业层面看，美光宣布存储芯片产业的寒冬已经过去，其 Q3 业绩指引高于市场预期、预期行业开始复苏，有望对 CSP 封装基板业务形成正向贡献。

四、公司下游分布介绍

公司 PCB 业务产品下游应用占比如下：通信约占 1/3，服务器、安防各占 15%-20%，工控、医疗各占 10%左右，其他行业约占 15%。公司 PCB 业务客户集中度低，多为下游多个行业领先企业或龙头企业，客户所涉行业较广，不依赖单一行业、单一客户，受下游客户单一行业周期、经济周期影响小。

公司半导体业务方面，目前 FCBGA 封装基板项目尚未投产，IC 封装基板业务以 CSP 封装基板、BT 材料为主。CSP 封装基板产品的下游应用占比如下：存储类占比约 2/3，指纹识别芯片、射频芯片、应用处理器芯片、传感器芯片等其他相关领域占比约 1/3。

五、北京收购项目的进展介绍

目前公司正积极推进对标的公司揖斐电电子（北京）有限公司的审计、业务对接等工作。待审计工作完成后，交易双方将根据《股权购买协议》约定的价格调整机制，对基础购买价格进行调整，公司将及时召开董事会审议相关事项。

六、公司后续扩产计划介绍

受国际形势复杂化、行业景气度低迷等因素影响，宏观经济受到一定冲击，也对公司新扩产能的释放产生了一定影响。在传统 PCB 领域的

重点将放在数字化改造，通过建立管理标准，借助先进的数字化技术手段，从设计、制造、仓储、物流实现全面数字化管理，在质量、技术、交期等环节提升传统 PCB 业务的竞争力，实现平稳增长。CSP 封装基板将在现有产能满产后启动扩产计划；FCBGA 项目将继续按计划推进建设进程。

七、2023 年行业景气度展望

从行业需求判断，2023 年 PCB 行业应该是前低后高趋势，2023 年 Q1 同比增速难有改善，预期 Q2 开始环比改善，三四季度行业同比增速转正，整体回暖幅度取决于宏观经济复苏的力度。

八、公司未来发展方向

数字化和封装基板是公司未来的战略方向和重点投资领域，在传统 PCB 行业不会再做过多的资本投入，通过数字化改造提升交期、良率以提升整体竞争力是主要方向，封装基板业务则是 AI 时代背景下的必然选择。

2023 年是公司全面数字化变革的奋进之年，“订单&计划数字化转型”项目已在 PCB 广州事业部、PCB 宜兴事业部和 BGA 事业部得以落地，力争通过一年时间实现订单&计划领域专业能力领先，之后将数字化转型机制推广至公司各事业部和职能平台，构建一个可扩展的业务能力平台，全面改造公司整体管理模式和工厂运营模式，实现兴森制造到兴森智造的战略转型，最终达到提升生产效率、降低生产成本、提高产品质量的目的。

尽管面临行业景气周期的波动和阶段性的成本负担，公司仍坚定推进 FCBGA 封装基板项目的投资扩产，整体投资建设进度按计划进行，后续的主要工作则聚焦于工厂良率提升、客户拓展和量产导入，与国际一线厂商同台竞技则是对公司整体能力的重大考验。

附件清单	无
日期	2023 年 3 月 31 日